

第 11 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 27 年 9 月 15 日(火) 10:30~16:30

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室 (東京都中央区)

時間	題 目	講 演 者
10:30~ 11:50	司会 松嶋 道也 (大阪大学)	
	『SiCパワーデバイス向け高耐熱ダイボンド用 ナノ銀ペースト』 (40分)	(株)日本スペリア社 ○西田 光宏
	『導電性接着剤の硬化収縮と電気伝導について』 (40分)	○小日向 茂
11:50~ 12:50	昼 食 休 憩	
12:50~ 13:00	委 員 会 議 事	
13:00~ 14:50	司会 青島 正貴 (トヨタ自動車(株))	
	『薄いAuキャップ付きAg, Cu, Al薄膜を用いたウエ ハの大気中室温接合』 (30分)	東北大学 ○魚本 幸、島津 武仁
	『フリップチップにおけるCu-Cu超音波接合評価』 (40分)	東レエンジニアリング(株) ○新井 義之
	『パワーデバイス用高耐熱高放熱接着シートの 開発』 (40分)	(株)ADEKA ○福田 芳弘
14:50~ 15:10	休 憩	
15:10~ 16:30	司会 山中 公博 (中京大学)	
	『パネルレベルパッケージの三次元実装への展開』 (40分)	(株) ジェイデバイス ○高橋 知子、澤地 茂典、井上 広司 平井 達也、大井田 充、蛭田 陽一
	『M2M/IoT/IeTを支えるウェアブル機器・センサーモ ジュールに向けた“部品内蔵基板技術”とその進化』 (40分)	日本シイエムケイ(株) ○猪川 幸司

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。